

行動裝置需求續增，激勵半導體產值呈二位數成長

1. 我國半導體產業 103 年 1 至 5 月產值 6,003 億元，年成長 14.2%，其中以積體電路業產值 3,916 億元占 65% 為最大宗，半導體封裝及測試業產值 1,647 億元占 27% 居次，兩者合占逾九成，年增率各為 14.7% 及 16.6%。
2. 按主要產品觀察，晶圓代工因行動裝置不斷推陳出新，加以電腦市場回溫及智慧科技應用領域迅速擴展，激勵晶圓代工產值年增 11.3%；DRAM 受惠於行動裝置銷售熱潮，支撐價格持續攀升，致 103 年 1 至 5 月產值較上年同期大幅成長 56.9%；構裝 IC 和 IC/晶圓測試亦受惠於手機晶片接單強勁及晶圓代工產量攀升，致產值分別年增 17.8% 及 8.3%，顯示受惠於行動裝置之崛起，半導體產業之上中下游產值顯著成長。
3. 我國半導體產業直接外銷比率達七成四，其中積體電路直接外銷比率高達近八成，主要以外銷為主。103 年 1 至 6 月積體電路出口總值 335 億美元，較上年同期成長 11.9%，主要出口市場以中國大陸及香港占 53.4% 居首，年增率為 18.3%；新加坡占 18.5% 次之，年增率為 5.3%；對南韓及日本出口各占 8.7% 及 5.9%，上半年呈負成長 7.0% 及 6.7%；對馬來西亞及菲律賓各增 39.4% 及 26.4%，成長最為快速。

我國半導體產業產值統計

金額單位：億元

業別及產品	100年	101年	102年	103年		
				1-5月	較上年同期增減%	
我國半導體產業	11,770	12,264	13,621	11.1	6,003	14.2
積體電路業	7,070	7,653	8,892	16.2	3,916	14.7
DRAM	1,069	827	1,155	39.7	615	56.9
晶圓代工	5,456	6,375	7,412	16.3	3,206	11.3
分離式元件業	1,100	995	1,045	5.0	441	2.1
二極體	173	140	156	11.1	74	24.0
電晶體	25	24	28	18.1	13	25.6
其他半導體製造零配件	902	832	862	3.6	355	-2.1
半導體封裝及測試業	3,600	3,616	3,684	1.9	1,647	16.6
構裝 IC	2,848	2,888	3,037	5.1	1,359	17.8
IC/晶圓測試	685	698	680	-2.5	293	8.3

資料來源：經濟部統計處。

我國積體電路出口總值-按出口地區分

金額單位：百萬美元

出口地區	100年		101年		102年		103年		
		年增率%		年增率%		年增率%	1-6月	年增率%	占比%
合 計	55,528	10.6	57,886	4.2	62,823	8.5	33,480	11.9	100.0
中國大陸及香港	28,350	8.3	29,156	2.8	32,066	10.0	17,863	18.3	53.4
新加坡	10,340	50.2	11,353	9.8	11,773	3.7	6,200	5.3	18.5
南韓	5,585	30.5	6,008	7.6	6,119	1.8	2,919	-7.0	8.7
日本	3,484	-37.1	3,814	9.5	4,643	21.7	1,985	-6.7	5.9
馬來西亞	1,802	11.7	1,893	5.1	2,244	18.6	1,196	39.4	3.6
菲律賓	1,870	2.3	1,666	-10.9	1,690	1.4	992	26.4	3.0
美國	1,393	12.8	1,204	-13.6	1,356	12.6	694	13.7	2.1
其他地區	2,705	3.3	2,792	3.2	2,931	5.0	1,631	15.2	4.9

資料來源：財政部關務署。

附註：1. 積體電路出口係以海關稅則號別8542節項下之商品出口總值。

2. 103年6月出口資料為初步值。